

ТУ 2242-003-07502963-2012

ТОКОПРОВОДЯЩИЕ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЕ КЛЕЙ И ПАСТА

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ПАЙКИ НА ОПЕРАЦИЯХ:

- монтажа элементов, интегральных схем;
- посадки кристаллов в производстве полупроводниковых приборов, интегральных схем и монтажа изделий пьезоэлектроники.

Применение драгоценных металлов в качестве проводника тока позволяет получить надежное и долговечное токопроводящее соединение или покрытие.

Использование токопроводящих клеев и паст позволяет автоматизировать процесс посадки кристаллов полупроводниковых приборов.

КЛЕЙ ТСК-1

Клей ТСК-1 используется при монтаже электронных схем, скреплении деталей в радиоприборах, сборке чип-конденсаторов и монтаже термопроводящих механизмов. Клей выпускается в шприцах дозирования с люэровским замком различного объема. Такие шприцы позволяют применять токопроводящий клей в системах автоматического пневмодозирования. Применяемые полимерные связующие в композиции клея ТСК-1 имеют адгезивность не менее чем 4,5 МПа (прочность при сдвиге). Высокая адгезия клея к различным веществам позволяет удерживать приклеиваемые детали на стадии монтажа. Отверждение клея происходит при температуре $165 \pm 5^\circ\text{C}$ в течение 30 минут.

Транспортировку и хранение клея ТСК-1 не допускается осуществлять при температуре не выше минус 15°C . Перед использованием клея его требуется выдержать при комнатной температуре в течение 30 минут. Допускается многократное использование клея с дальнейшим хранением в морозильной камере при условии суммарной работы при комнатной температуре не более 12 часов.

ПАСТА ТСП-1

Паста ТСП-1 предназначена для изготовления проводников методом трафаретной печати или нанесения погружением, например, для формирования электропроводящего финишного слоя катода секции чип-конденсатора. Сушка пасты осуществляется в два этапа: при комнатной температуре в течение 30 минут, далее при температуре $165\pm 5^{\circ}\text{C}$ в течение 30 минут.

При работе с пастами важно обеспечить требуемую технологическую вязкость, обеспечивающую необходимую толщину и равномерность покрытия. Для серебряносодержащей пасты ТСП-1 корректировка технологической вязкости производится добавлением растворителя, который поставляется в комплекте.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Токопроводящие клей и паста производства АО «ИЭМЗ «Купол» представляют собой однокомпонентные композиции, на основе мелкодисперсного серебра. Токопроводящий серебряносодержащий клей ТСК-1 и токопроводящая серебряносодержащая паста ТСП-1 с удельным электрическим сопротивлением не более $5\cdot 10^{-4}$ Ом·см ($5\cdot 10^{-6}$ Ом·м) соответствуют требованиям ТУ 2242-003-07502963-2012 «Клеи и паста металлсодержащие для конденсаторов».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	КЛЕЙ ТСК-1	ПАСТА ТСП-1
Содержание серебра	76–80 %	53–61 %
Температура отверждения	$165\pm 5^{\circ}\text{C}$	$165\pm 5^{\circ}\text{C}$
Время отверждения: – в нормальных условиях (для удаления растворителя) – при температуре ($165\pm 5^{\circ}\text{C}$)	30 МИН.	30 МИН.
Электрическое сопротивление (после отверждения), не более	$5\cdot 10^{-6}$ Ом·м ($5\cdot 10^{-4}$ Ом·см)	$5\cdot 10^{-6}$ Ом·м ($5\cdot 10^{-4}$ Ом·см)
Прочность на сдвиг ГОСТ 14759-69, не менее	4,5 МПа	1,5 МПа
Температура хранения	-15°C	Н. У.
Гарантийный срок хранения	5 МЕСЯЦЕВ при темп. -15°C	6 МЕСЯЦЕВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РБ ООО «СЕТКОМ»


ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

-  Адрес офиса: 220104, г. Минск, ул. П. Глебки 11/3, помещение 2
Адрес склада: г. Минск, ул. П. Глебки 11
-  +375 17 355 29 29, +375 29 355 29 29, +375 29 334 55 55
-  gc.setcom@gmail.com, evgsetcom@gmail.com